



nepes

2021 纳沛斯集团简介



Semiconductor | Neuromorphic AI | IT Materials | Energy | 2ndary battery



关于纳沛斯



事业领域



核心技术



国际化纳沛斯



企业文化

HYPER
CONNECTING
TECHNOLOGY



企业品牌



纳沛斯在决定公司名称的那一刻就开始了4D管理



词源(希伯来语)

חיי נצח (khai nepes)

永恒的生命 / 精力充沛

长寿企业



什么是 4D (4th dimension) 管理?

为了让公司能成为有丰盛收获的长寿企业，
使**创造、创新、创拓**事宜和**有趣、满足、快乐**事宜
不断发生的经营管理。

Corporate Identity



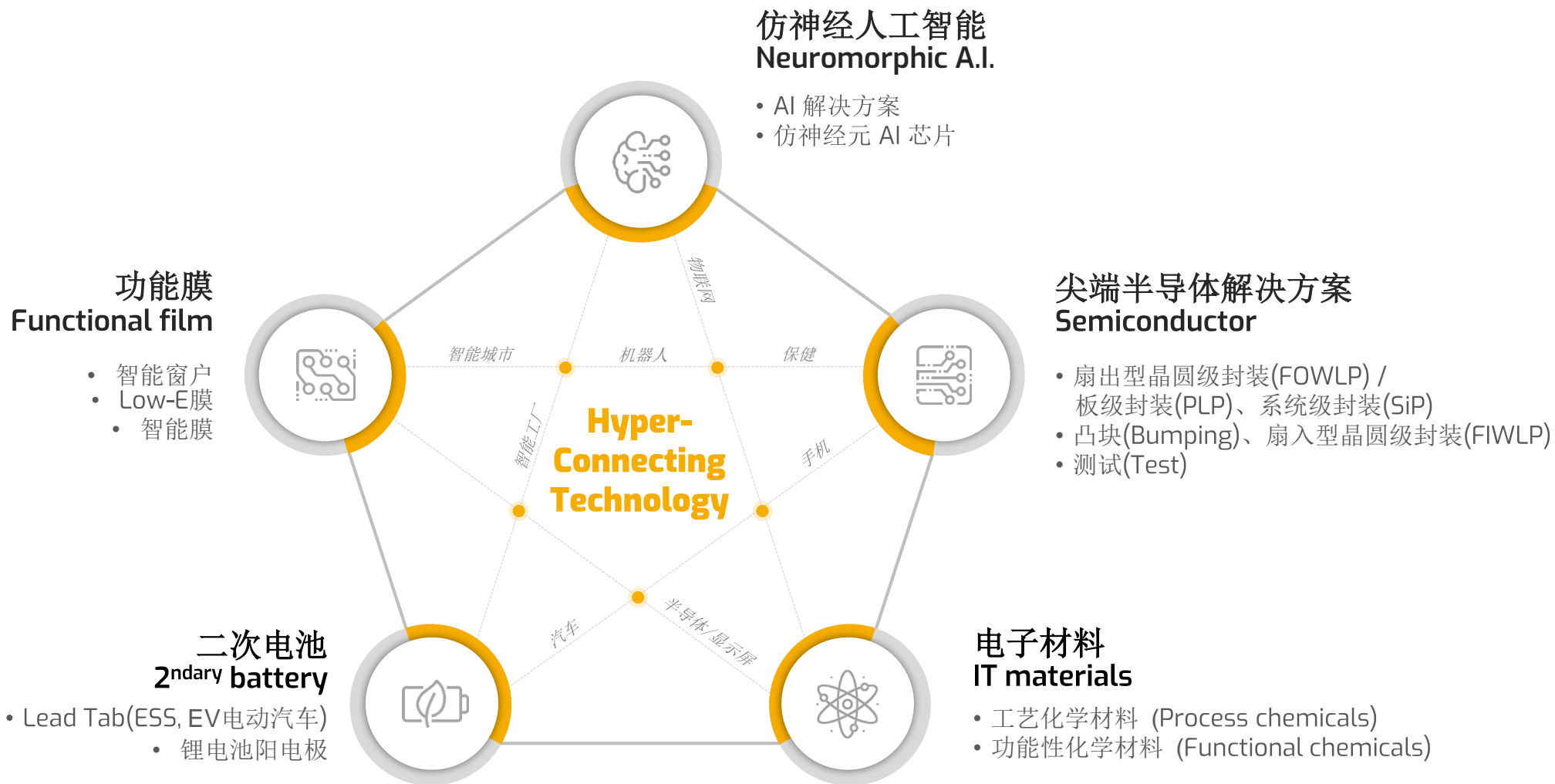
Trademark



公 司 名	株式会社 纳沛斯
公司成立日	1990年 12月
公司上市日	1999年 12月 (KOSDAQ 033640)
集团董事长	李柄九 (Byung-Koo Lee) 先生
海 外 法 人	中国、美国、菲律宾, 印度尼西亚, 俄罗斯



纳沛斯创造连接未来事业的超链接技术 (Hyper-connecting Technology)





产品及服务

- 工厂用AI解决方案
- 视觉用AI解决方案
- 监控用AI解决方案
- 仿神经元AI芯片

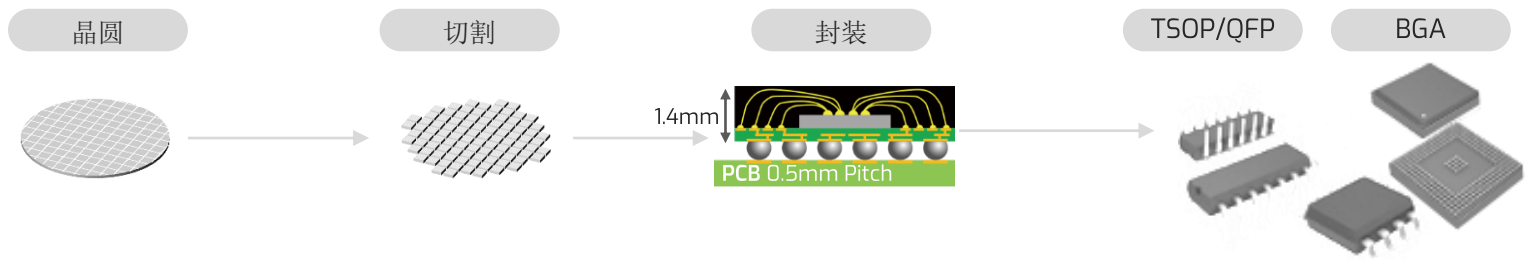




超高性能及更小巧轻薄的 **End FAB** 解决方案



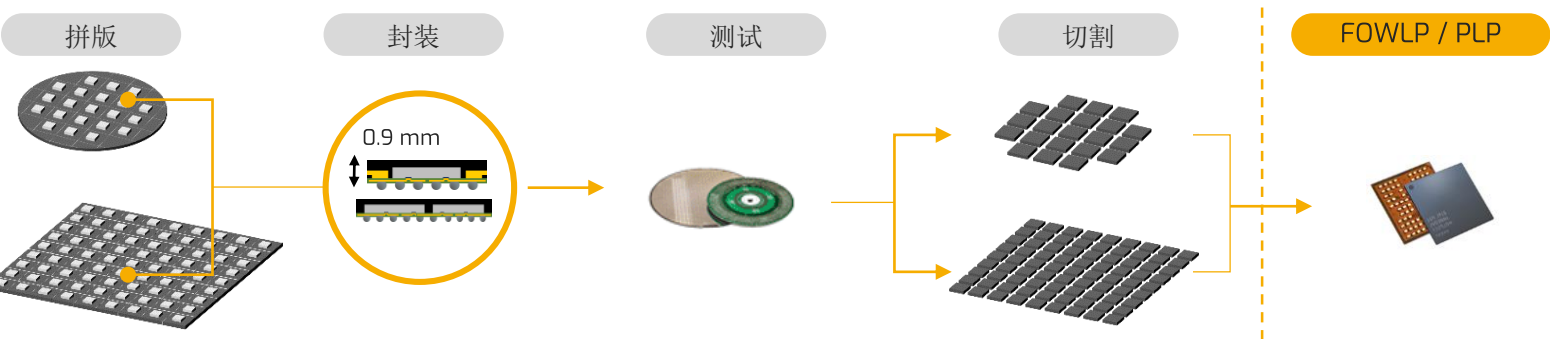
传统封装



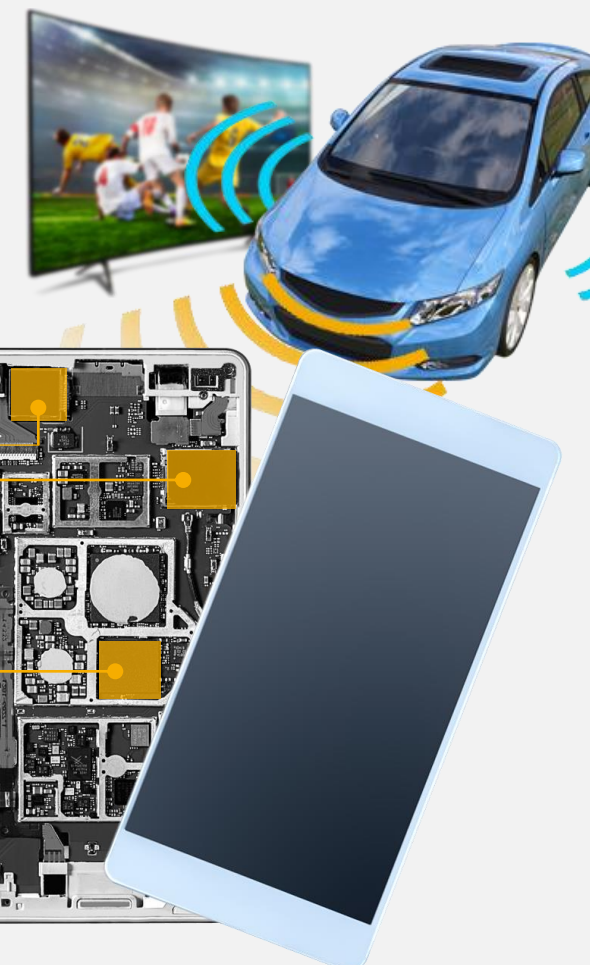
晶圆级封装 WLP



FOWLP / PLP



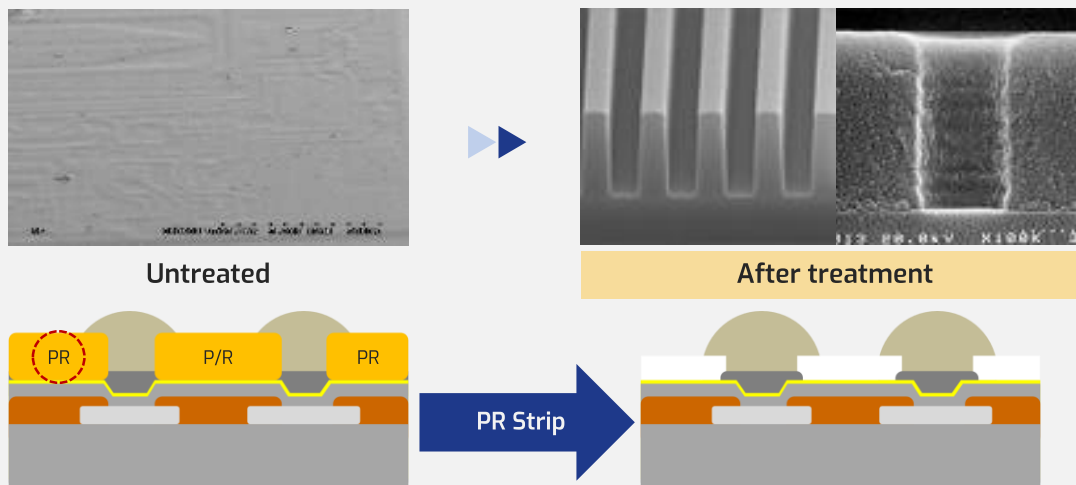
应用产品





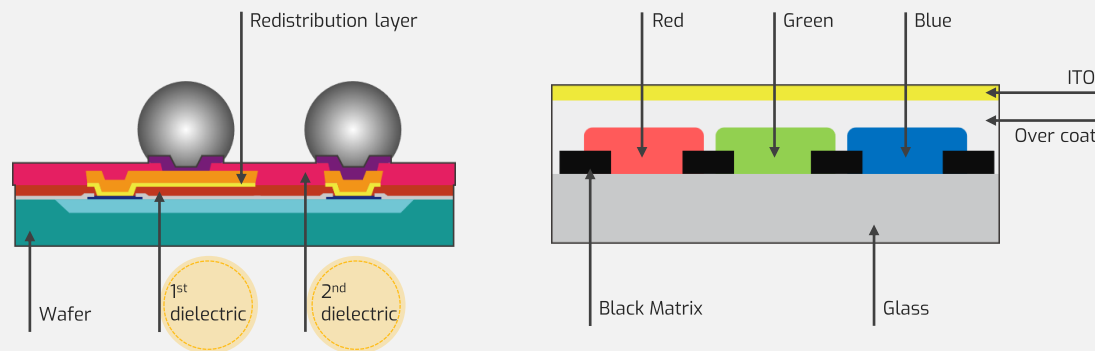
Process chemical

- PR
- 显影液 (Developer)
- PSPI Developer
- 剥离剂 (Stripper)
- 蚀刻剂 (Etchant)
- HSN
- PV texture



Functional chemical

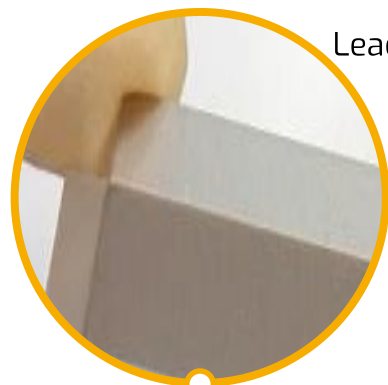
- ILD
- 铜镀液 (Cu Plating)
- Color paste



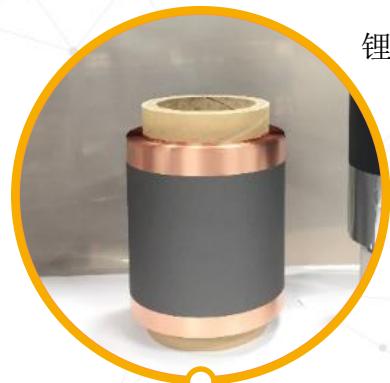
应用产品



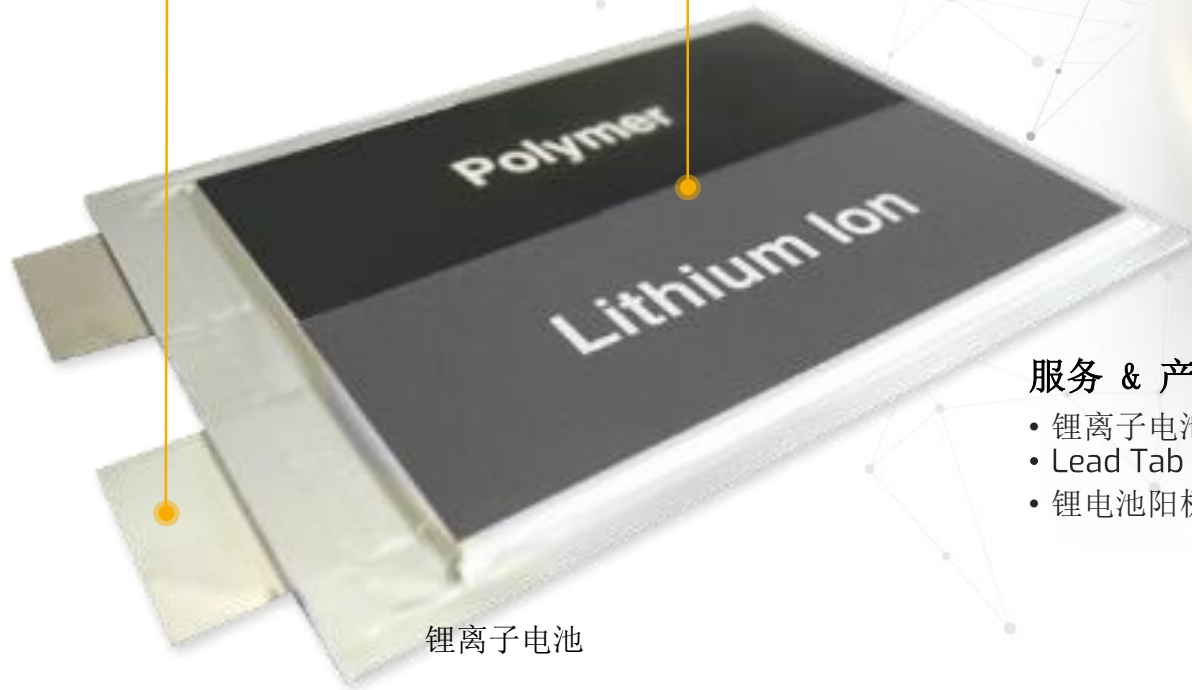
半导体
显示屏(LCD, OLED)
太阳能电池



Lead Tab



锂电池阳极



锂离子电池

服务 & 产品

- 锂离子电池
- Lead Tab
- 锂电池阳极电极

应用范围



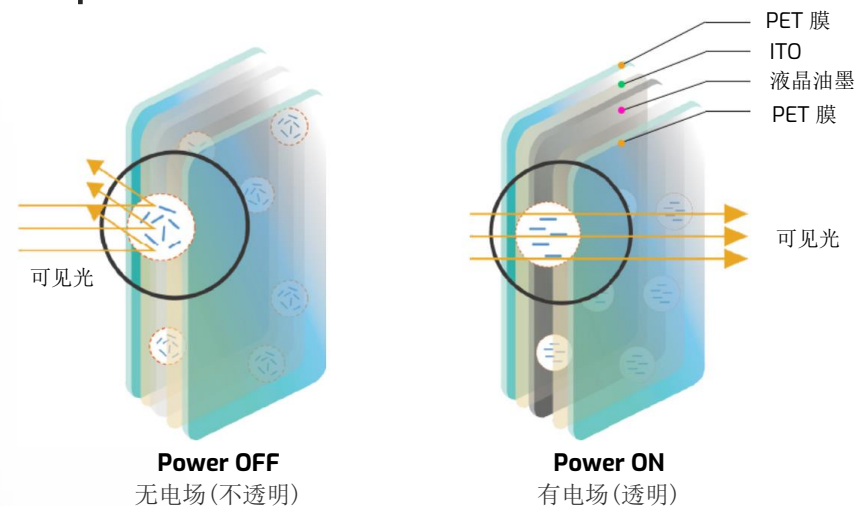


变色膜 (Super LC)



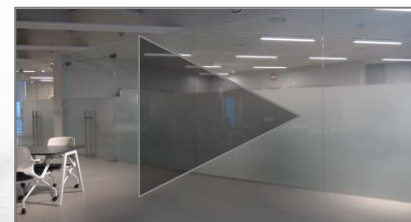
Low-E膜 (Pentix®)

Super LC的结构及原理



服务 & 产品

- Smart Windows (on/off)
- Low-E film (Pentix50, Pentix60)





调光眼镜膜

服务 & 产品

- 智能墨镜
- AR/VR眼镜
- 可切换型镜子
- 汽车用产品

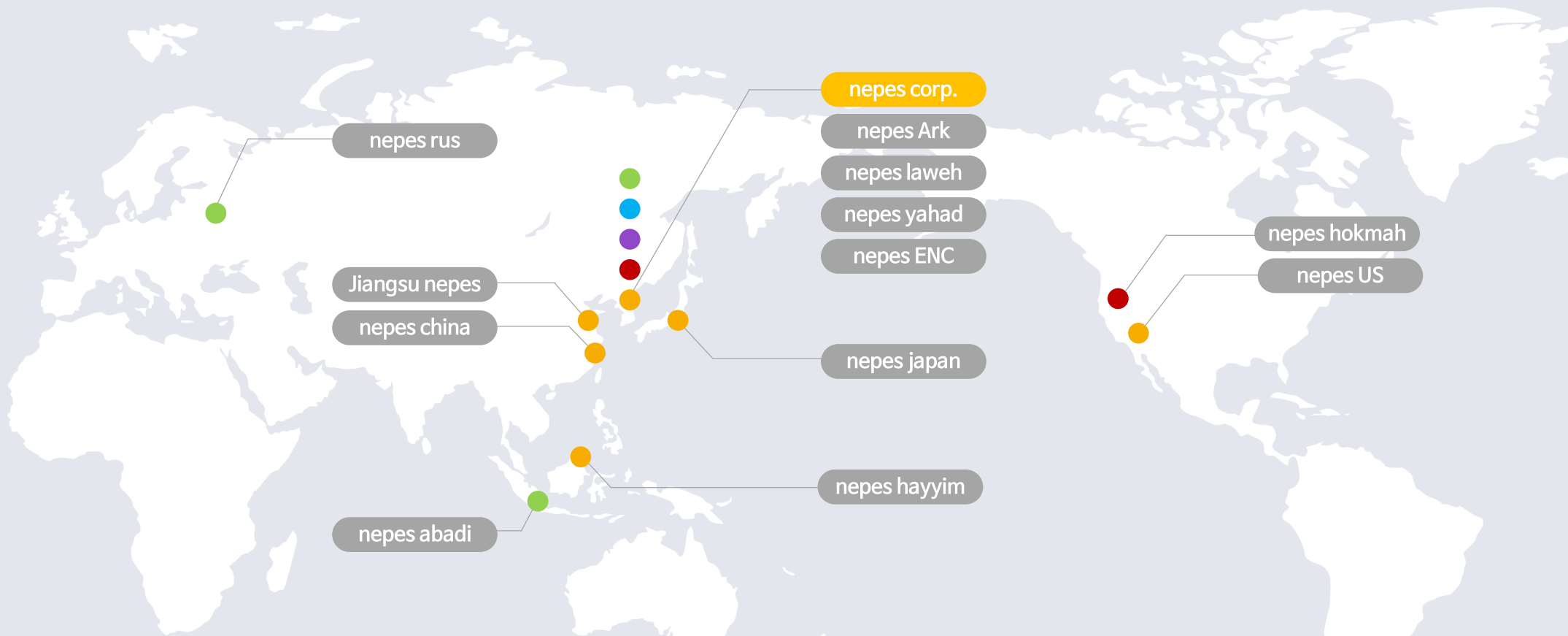




国际化纳沛斯



将我们的技术和产品服务于世界各地。



- Semiconductor
- Energy
- IT materials
- Neuromorphic A.I
- 2ndary battery



企业文化



纳沛斯以企业文化为基础创造业绩来持续成长



Global
NO.1
企业文化



3.3.7 LIFE



nepes
nepes corporation

感谢！

To Him who alone does great wonders, His love endures forever. Psalm 136:4

* A dandelion means 'Gratitude' in the language of flowers

nepes corporation

2415, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea

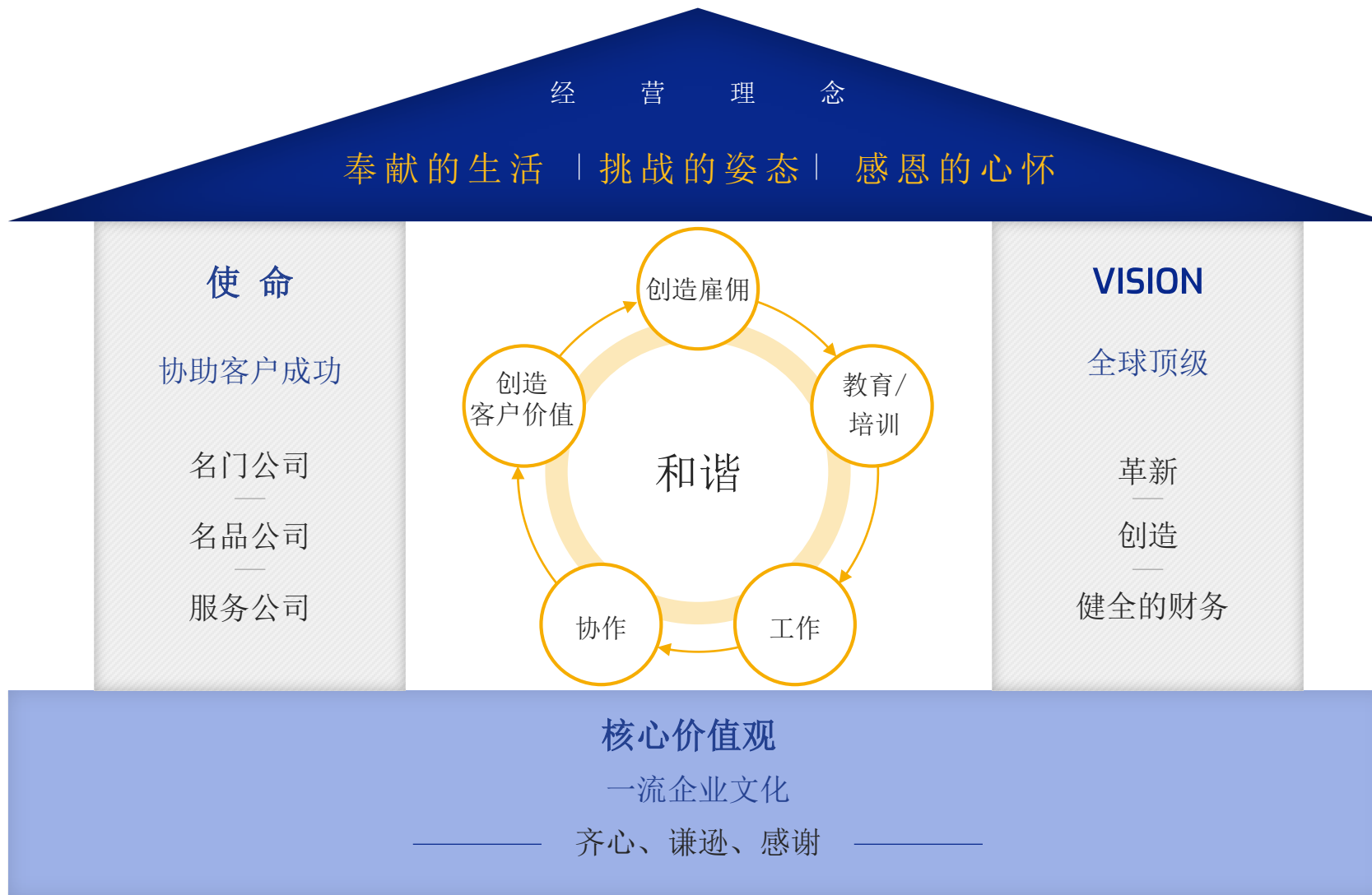
Tel : 02-3470-2700

Fax : 02-3470-2708

URL : www.nepes.co.kr



纳沛斯是以一贯性的实践来实现 **经营理念** 的企业





纳沛斯是 **优秀人才集合在一起的共同体。**



nepes LOGO



‘以感谢联接的n家族共同体’

固有的问候语

superstar

‘superstar’ 是尊重对方
纳沛斯固有的尊称招呼语

市场趋势

小型规格
(基于晶圆级平台)

高集成度晶圆级系统封装

技术路标规划

Conventional PKG

1.4mm

Chip

QFP

QFN

FCBGA

Bumping

Gold

Solder

Etc(Cu Pillar, CNA bumping)

WLP

8"WLP

12"WLP

Chip 0.4mm

Fan-out WLP/PLP

nPLP™

600x600mm

Chip 0.9mm

System in PKG

Multi-Chip Packaging

Si GaAs

System in packaging

Chip

One Package Module

- AP, PMIC
- Flash Memory
- **Neuromorphic**

定位

Other OSAT
Conventional wire bonding packaging & Typical WLP technology

nepes End FAB Solution
(Bump, WLP, FOWLP, FOPLP, SiP, TEST)

